

日立金属镀层测厚仪 CMI243（原英国牛津）

螺丝、零部件、螺栓、紧固件专用



概述

日立涂层测厚仪是一款灵便、易用的仪器，专为金属表面电镀处理者设计。配置的单探头可测量铁质底上所有金属镀层-即使在很小的、形状特殊的或表面粗糙的样品上都可以进行测量。这款测厚仪是螺丝、螺母、零部件、紧固件行业应用的理想工具。采用基于相位的相位涡流技术。

主要功能

优势：紧固件行业应用的理想工具，采用基于相位的电涡流技术集测量准确、价格合理、质量可靠的优势于一体的手持式涂镀层测厚仪

- 采用基于相位的电涡流技术，集测量准确、价格合理、质量可靠的优势于一体的手持式测厚仪。
- 专为金属表面电镀处理者设计。配置的单探头可测量，铁质底上所有金属镀层-即使在很小的、形状特殊的或表面粗糙的样品上都可以进行测量。
- 易于用户控制，并且可以同X线荧光测仪的准确性和精密性媲美。
- 为了让客户能以低成本购买镀层免去了对多探头、操作培训和持续保养的需要。

技术参数

项目	CMI243
准确度:	相对标准片±3%
准确度:	0.3%
分辨率:	0.1 μm
电涡流:	遵循 DIN50984, BS5411 Part 3, ISO 2360, ISO 21968 草案, ASTM B499, 及 ASTM E376
存储量:	26,500 条存储读数
尺寸:	14.9 x 7.94 x 3.02 cm
重量:	0.26 kg 包括电池
单位:	英制和公制的自动转换
接口:	RS-232 串行接口，波特率可调，用于下载至打印机或计算机

显示屏:	三位数 LCD 液晶显示
电池:	9 伏碱性电池, 65 小时连续使用
<p>先进的 ECP-M 探头: ECP-M 探头专为较难测量的金属镀层设计, 此单探头可以测量, 铁质底材上几乎所有金属镀层, 例如锌、镍、铜、铬和镉。更小的探针为很小的、形状特殊的或表面粗糙的零件提供了便捷的测量。</p>	

ECP-M 探头规格

最小凸面半径	1.143 mm
最小凹面半径	1.524 mm
测量高度	101.6 mm
最小测量直径	2.286 mm
底材最小	304.8 um

基本配置

ECP-M 探头及拆除指南
Rs232 串行电缆
校准用铁上镀锌标准片组

测量技术

一般的测试方法, 例如一般测厚仪制造商所采用的普通磁感应和涡流方式, 由于探头的" 升离效应" 导致的底材效应, 和由于测试件形状和结构导致的干扰, 都无法达到对金属性镀层厚度的准确测量。

日立仪器对电涡流技术的独特应用, 将底材效应最小化, 使得测量准确且不受零件的几何形状影响。

另外, 仪器一般不需要在铁质底材上进行校准。

产品展示

